

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

## 新聞稿

# 華虹半導體二零二三年第一季度業績公佈

*所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。*

*本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。*

中國香港 — 2023年5月11日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零二三年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

### 二零二三年第一季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入達 6.308 億美元，同比上升 6.1%，環比持平。
- 毛利率 32.1%，同比上升 5.2 個百分點，環比下降 6.1 個百分點。
- 期內溢利 1.409 億美元，同比上升 38.0%，環比下降 24.2%。
- 母公司擁有人應佔溢利 1.522 億美元，同比上升 47.9%，環比下降 4.3%。
- 基本每股盈利 0.116 美元，同比上升 46.8%，環比下降 4.9%。
- 淨資產收益率（年化）19.6%，同比上升 5.5 個百分點，環比下降 2.4 個百分點。

### 二零二三年第二季度指引

- 我們預計銷售收入約 6.30 億美元左右。
- 我們預計毛利率約在 25%至 27%之間。

## 總裁致辭

公司總裁兼執行董事唐均君先生對 2023 年第一季度業績評論道：

“儘管當前芯片領域低迷狀態尚未改善，部分客戶庫存還處於較高水平，公司仍通過調整產品組合以及銷售策略，強化與包括新能源汽車在內的產業鏈客戶的業務協同來更好地滿足市場需求，以求壯大公司非易失性存儲器以及功率半導體等平臺的市場供給，使產能利用率保持高位運行。華虹半導體 2023 年第一季度銷售收入為 6.308 億美元，同比上升 6.1%，環比持平。受到季節性、年度維修及折舊增加等因素影響，本季度毛利率為 32.1%，同比上升 5.2 個百分點，環比下降 6.1 個百分點。”

唐總繼續講道：“2023 年內，公司的無錫 12 英寸生產線將逐步釋放月產能至 9.5 萬片，並將適時啟動新產線的建設，為公司特色工藝的中長期發展提供產能支持，以更好地滿足市場對華虹先進“特色 IC + Power Discrete”工藝的需求。依託多元化的特色工藝平臺、專精深厚的研發實力、長期合作的全球客戶群體，華虹半導體必將厚積薄發、再上新臺階！”

## 電話會議公告

- 日期 2023 年 5 月 11 日（星期四）
- 時間： 16:00 香港/上海時間  
04:00 美國東部時間
- 發言人： 唐均君，總裁兼執行董事  
王鼎，執行副總裁兼首席財務官
- 廣播： 會議將在 [http://www.huahonggrace.com/c/investor\\_webcast.php](http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php) 或  
<https://edge.media-server.com/mmc/p/o49owufr> 作線上直播  
(請提前註冊登記)
- 電話直撥： 請在會議前使用以下鏈接先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼及個人 PIN。  
  
<https://register.vevent.com/register/BI0698e7eb50d84ab8bd1e2dcd642579b6>
- 重要提示：** 在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的個人 PIN 才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共享您的 PIN。
- 網上重播： 直播約 12 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。  
  
[http://www.huahonggrace.com/c/investor\\_webcast.php](http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php)

## 關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（「本公司」）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，專注於嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等「8 英寸 + 12 英寸」特色工藝技術的持續創新，先進「特色 IC + Power Discrete」強大的工藝技術平台有力支持物聯網等新興領域應用，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是以集成電路製造為主業，擁有「8 英寸 + 12 英寸」生產線先進工藝技術的企業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約 18 萬片。同時在無錫高新技術產業開發區內有一座月產能 6.5 萬片的 12 英寸晶圓廠（華虹七廠），是國內領先的 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料，請瀏覽：[www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)。

**經營業績概要**  
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二三年 第一季度 (未經審核)	二零二二年 第一季度 (未經審核)	二零二二年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	630,842	594,648	630,110	6.1 %	0.1 %
<b>毛利</b>	<b>202,197</b>	<b>160,023</b>	<b>240,707</b>	<b>26.4 %</b>	<b>(16.0)%</b>
<b>毛利率</b>	<b>32.1 %</b>	<b>26.9 %</b>	<b>38.2 %</b>	5.2	(6.1)
經營開支	(76,261)	(75,264)	(59,579)	1.3 %	28.0 %
其他收入淨額	6,066	10,479	35,565	(42.1)%	(82.9)%
<b>稅前溢利</b>	<b>132,002</b>	<b>95,238</b>	<b>216,693</b>	<b>38.6 %</b>	<b>(39.1)%</b>
所得稅抵免/(開支)	8,900	6,865	(30,918)	29.6 %	(128.8)%
<b>期內溢利</b>	<b>140,902</b>	<b>102,103</b>	<b>185,775</b>	<b>38.0 %</b>	<b>(24.2)%</b>
<b>淨利潤率</b>	<b>22.3 %</b>	<b>17.2 %</b>	<b>29.5 %</b>	5.1	(7.2)
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	152,234	102,944	159,136	47.9 %	(4.3)%
非控股權益	(11,332)	(841)	26,639	1,247.4 %	(142.5)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.116	0.079	0.122	46.8 %	(4.9)%
攤薄	0.115	0.078	0.121	47.4 %	(5.0)%
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	1,001	1,057	992	(5.3)%	0.9 %
產能利用率 <sup>1</sup>	103.5 %	106.0 %	103.2 %	(2.5)	0.3
淨資產收益率 <sup>2</sup>	19.6 %	14.1 %	22.0 %	5.5	(2.4)

**二零二三年第一季度**

- 銷售收入達 6.308 億美元，同比上升 6.1%，環比持平。
- 毛利率 32.1%，同比上升 5.2 個百分點，主要得益於平均銷售價格上漲，部分被折舊成本上升所抵消，環比下降 6.1 個百分點，主要由於折舊、原材料和動力成本上升。
- 經營開支 7,630 萬美元，同比持平，環比上升 28.0%，主要由於研發活動的政府補助減少。
- 其他收入淨額 610 萬美元，同比下降 42.1%，主要由於財務費用增加，部分被外幣匯兌收益及利息收入增加所抵消，環比下降 82.9%，主要由於財務費用增加，分占聯營公司溢利及外幣匯兌收益減少。
- 所得稅抵免 890 萬美元，同比上升 29.6%，主要由於以前年度計提的代扣代繳股息稅的轉回增加。
- 期內溢利 1.409 億美元，同比上升 38.0%，環比下降 24.2%。
- 母公司擁有人應佔溢利 1.522 億美元，同比上升 47.9%，環比下降 4.3%。
- 基本每股盈利 0.116 美元，同比上升 46.8%，環比下降 4.9%。
- 淨資產收益率 (年化) 19.6%，同比上升 5.5 個百分點，環比下降 2.4 個百分點。

<sup>1</sup>產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

<sup>2</sup>母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二三年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第一季度 % (未經審核)	二零二二年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	605,718	96.0 %	574,651	96.6 %	31,067	5.4 %
其他	25,124	4.0 %	19,997	3.4 %	5,127	25.6 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>630,842</b>	<b>100.0 %</b>	<b>594,648</b>	<b>100.0 %</b>	<b>36,194</b>	<b>6.1 %</b>

- 本季度 96.0%的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二三年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第一季度 % (未經審核)	二零二二年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	379,584	60.2 %	332,603	55.9 %	46,981	14.1 %
12 吋晶圓	251,258	39.8 %	262,045	44.1 %	(10,787)	(4.1)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>630,842</b>	<b>100.0 %</b>	<b>594,648</b>	<b>100.0 %</b>	<b>36,194</b>	<b>6.1 %</b>

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 3.796 億美元及 2.513 億美元。

### 銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二三年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第一季度 % (未經審核)	二零二二年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 <sup>3</sup>	477,155	75.7 %	451,638	76.0 %	25,517	5.6 %
北美 <sup>4</sup>	70,760	11.2 %	58,064	9.8 %	12,696	21.9 %
亞洲 <sup>5</sup>	39,062	6.2 %	54,885	9.2 %	(15,823)	(28.8)%
歐洲	37,344	5.9 %	22,081	3.7 %	15,263	69.1 %
日本 <sup>6</sup>	6,521	1.0 %	7,980	1.3 %	(1,459)	(18.3)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>630,842</b>	<b>100.0 %</b>	<b>594,648</b>	<b>100.0 %</b>	<b>36,194</b>	<b>6.1 %</b>

- 本季度來自於中國的銷售收入 4.772 億美元，占銷售收入總額的 75.7%，同比增長 5.6%，主要得益於 MCU、IGBT、智能卡芯片及超級結產品的需求增加，部分被 CIS、NOR flash、邏輯及其他電源管理的產品需求下降所抵消。
- 本季度來自於北美的銷售收入 7,080 萬美元，同比增長 21.9%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 3,910 萬美元，同比下降 28.8%，主要由於邏輯及分立器件產品的需求減少。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 3,730 萬美元，同比增長 69.1%，主要得益於智能卡芯片及 IGBT 產品的需求增加。
- 本季度來自於日本的銷售收入 650 萬美元，同比下降 18.3%，主要由於 MCU 產品的需求減少。

<sup>3</sup>包括中國大陸及中國香港。

<sup>4</sup>包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

<sup>5</sup>不包括中國及日本。

<sup>6</sup>包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

### 銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二三年	二零二三年	二零二二年	二零二二年	同比	同比
	第一季度 仟美元 (未經審核)	第一季度 % (未經審核)	第一季度 仟美元 (未經審核)	第一季度 % (未經審核)	仟美元	%
嵌入式非易失性存儲器	239,228	37.9 %	142,258	23.9 %	96,970	68.2 %
獨立式非易失性存儲器	31,802	5.0 %	58,546	9.8 %	(26,744)	(45.7)%
分立器件	232,640	36.9 %	181,342	30.6 %	51,298	28.3 %
邏輯及射頻	39,203	6.2 %	95,327	16.0 %	(56,124)	(58.9)%
模擬與電源管理	87,535	13.9 %	116,557	19.6 %	(29,022)	(24.9)%
其他	434	0.1 %	618	0.1 %	(184)	(29.8)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>630,842</b>	<b>100.0 %</b>	<b>594,648</b>	<b>100.0 %</b>	<b>36,194</b>	<b>6.1 %</b>

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 2.392 億美元，同比增長 68.2%，主要得益於 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 3,180 萬美元，同比下降 45.7%，主要由於 NOR flash 產品的需求減少。
- 本季度分立器件銷售收入 2.326 億美元，同比增長 28.3%，主要得益於 IGBT 及超級結產品的需求增加。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 3,920 萬美元，同比下降 58.9%，主要由於 CIS 及邏輯產品的需求減少。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 8,750 萬美元，同比下降 24.9%，主要由於其他電源管理產品的需求增加。

### 銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二三年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第一季度 % (未經審核)	二零二二年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
55nm 及 65nm	58,514	9.2 %	103,031	17.3 %	(44,517)	(43.2)%
90nm 及 95nm	119,348	18.9 %	124,360	21.0 %	(5,012)	(4.0)%
0.11 $\mu$ m 及 0.13 $\mu$ m	128,905	20.4 %	82,825	13.9 %	46,080	55.6 %
0.15 $\mu$ m 及 0.18 $\mu$ m	43,928	7.0 %	48,626	8.2 %	(4,698)	(9.7)%
0.25 $\mu$ m	4,146	0.7 %	3,802	0.6 %	344	9.0 %
0.35 $\mu$ m 及以上	276,001	43.8 %	232,004	39.0 %	43,997	19.0 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>630,842</b>	<b>100.0 %</b>	<b>594,648</b>	<b>100.0 %</b>	<b>36,194</b>	<b>6.1 %</b>

- 本季度 55nm 及 65nm 工藝技術節點的銷售收入 5,850 萬美元，同比下降 43.2%，主要由於 NOR flash、邏輯及 CIS 產品的需求減少，部分被模擬和 MCU 產品需求增加所抵消。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 1.193 億美元，同比下降 4.0%，主要由於其他電源管理及 CIS 產品需求減少，部分被智能卡芯片及 MCU 產品的需求增加所抵消。
- 本季度 0.11 $\mu$ m 及 0.13 $\mu$ m 工藝技術節點的銷售收入 1.289 億美元，同比增長 55.6%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.15 $\mu$ m 及 0.18 $\mu$ m 工藝技術節點的銷售收入 4,390 萬美元，同比下降 9.7%，主要由於邏輯產品的需求減少。
- 本季度 0.25 $\mu$ m 工藝技術節點的銷售收入 410 萬美元，同比增長 9.0%。
- 本季度 0.35 $\mu$ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 2.760 億美元，同比增長 19.0%，主要得益於 IGBT 及超級結產品的需求增加。



### 銷售收入分析

按終端市場分佈 劃分的銷售收入	二零二三年	二零二三年	二零二二年	二零二二年	同比	同比
	第一季度	第一季度	第一季度	第一季度		
	仟美元	%	仟美元	%	仟美元	%
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
電子消費品	368,695	58.4 %	395,076	66.3 %	(26,381)	(6.7)%
工業及汽車	180,229	28.6 %	106,154	17.9 %	74,075	69.8 %
通訊	62,809	10.0 %	72,847	12.3 %	(10,038)	(13.8)%
計算機	19,109	3.0 %	20,571	3.5 %	(1,462)	(7.1)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>630,842</b>	<b>100.0 %</b>	<b>594,648</b>	<b>100.0 %</b>	<b>36,194</b>	<b>6.1 %</b>

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 3.687 億美元，占銷售收入總額的 58.4%，同比下降 6.7%，主要由於其他電源管理、NOR flash 及邏輯產品的需求下降，部分被 MCU 及超級結產品的需求增加所抵消。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.802 億美元，同比增長 69.8%，主要得益於 IGBT、MCU 及通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 6,280 萬美元，同比下降 13.8%，主要由於 CIS 產品需求減少，部分被智能卡芯片的需求增加所抵消。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,910 萬美元，同比下降 7.1%。

### 產能<sup>7</sup>及產能利用率

晶圓廠(折合 8 吋仟片晶圓)	二零二三年	二零二二年	二零二二年
	第一季度	第一季度	第四季度
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
產能 (200mm)	178	178	178
產能 (300mm)	65	65	65
<b>合計產能</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
產能利用率 (200mm)	107.1%	107.7%	105.9%
產能利用率 (300mm)	99.0%	103.9%	99.9%
總體產能利用率	103.5%	106.0%	103.2%

- 本季度末月產能 324,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 103.5%。

<sup>7</sup> 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

### 付運晶圓

折合 8 吋仔片晶圓	二零二三年 第一季度 (未經審核)	二零二二年 第一季度 (未經審核)	二零二二年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	1,001	1,057	992	(5.3)%	0.9 %

- 本季度付運晶圓 1,001,000 片，同比下降 5.3%，環比上升 0.9%。

### 經營開支分析

以千美元計	二零二三年 第一季度 (未經審核)	二零二二年 第一季度 (未經審核)	二零二二年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,688	4,496	2,914	(40.2)%	(7.8)%
管理費用 <sup>8</sup>	73,573	70,768	56,665	4.0 %	29.8 %
<b>經營開支</b>	<b>76,261</b>	<b>75,264</b>	<b>59,579</b>	<b>1.3 %</b>	<b>28.0 %</b>

- 經營開支 7,630 萬美元，同比持平，環比上升 28.0%，主要由於研發活動的政府補助減少。

### 其他收入淨額

以千美元計	二零二三年 第一季度 (未經審核)	二零二二年 第一季度 (未經審核)	二零二二年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,464	3,781	3,352	(8.4)%	3.3 %
利息收入	11,364	4,322	10,775	162.9 %	5.5 %
匯兌收益	16,536	7,140	22,054	131.6 %	(25.0)%
分佔聯營公司溢利	1,520	1,855	7,311	(18.1)%	(79.2)%
財務費用	(28,413)	(6,786)	(8,465)	318.7 %	235.7 %
政府補貼	788	1,842	678	(57.2)%	16.2 %
其他	807	(1,675)	(140)	(148.2)%	(676.4)%
<b>其他收入淨額</b>	<b>6,066</b>	<b>10,479</b>	<b>35,565</b>	<b>(42.1)%</b>	<b>(82.9)%</b>

- 其他收入淨額 610 萬美元，同比下降 42.1%，主要由於財務費用增加，部分被外幣匯兌收益及利息收入增加所抵消，環比下降 82.9%，主要由於財務費用增加，分佔聯營公司溢利及外幣匯兌收益減少。

<sup>8</sup>管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

### 現金流量分析

以千美元計	二零二三年 第一季度 (未經審核)	二零二二年 第一季度 (未經審核)	二零二二年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	131,868	195,589	184,413	(32.6)%	(28.5)%
投資活動所用現金流量淨額	(203,281)	(116,986)	(303,135)	73.8 %	(32.9)%
融資活動所得現金流量淨額	263,249	2,439	120,141	10,693.3 %	119.1 %
外匯匯率變動影響淨額	17,946	3,752	23,118	378.3 %	(22.4)%
<b>現金及現金等價物變動影響淨額</b>	<b>209,782</b>	<b>84,794</b>	<b>24,537</b>	<b>147.4 %</b>	<b>755.0 %</b>

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 1.319 億美元，同比下降 32.6%，主要由於材料和維護等支出增加，環比下降 28.5%，主要由於本季度支付了上年度年終獎金。
- 投資活動所用現金流量淨額 2.033 億美元，其中包括固定資產及無形資產投資支出 2.166 億美元，部分被收到利息收入 1,330 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 2.632 億美元，其中非控股權益資本注資 2.962 億美元，提取銀行借款 1,300 萬美元，及發行股份收到 140 萬美元，部分被償還銀行貸款本金 4,250 萬美元，支付利息 380 萬美元，租賃負債支出 80 萬美元，及支付上市費用 30 萬美元所抵消。

### 資本結構

以千美元計	於三月三十一日 二零二三年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二二年 (未經審核)
資產總額	7,378,331	7,055,376
負債總額	2,747,651	2,919,908
所有者權益總額	4,630,680	4,135,468
資產負債率 <sup>9</sup>	37.2%	41.4%

### 資本開支

以千美元計	二零二三年 第一季度 (未經審核)	二零二二年 第四季度 (未經審核)
華虹 8 吋	25,642	20,169
華虹無錫	190,978	310,896
<b>合計</b>	<b>216,620</b>	<b>331,065</b>

- 本季度資本開支 2.166 億美元，其中 1.910 億美元用於華虹無錫。

<sup>9</sup>資產負債率=負債總額/資產總額。

## 流動性分析

以千美元計	於三月三十一日 二零二三年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二二年 (未經審核)
發展中物業	143,960	134,723
存貨	593,922	578,060
貿易應收款項及應收票據	306,062	291,856
預付款項、其他應收款項及其他資產	38,657	48,273
應收關聯方款項	15,348	13,006
已凍結存款及定期存款	1,056	1,042
現金及現金等價物	2,218,547	2,008,765
<b>流動資產總額</b>	<b>3,317,552</b>	<b>3,075,725</b>
貿易應付款項	220,243	236,999
其他應付款項及暫估費用	441,795	593,971
計息銀行借款	408,669	426,756
租賃負債	5,582	4,704
政府補助	38,165	37,714
應付關聯方款項	7,944	6,096
應付所得稅	98,314	76,176
<b>流動負債總額</b>	<b>1,220,712</b>	<b>1,382,416</b>
<b>淨營運資金</b>	<b>2,096,840</b>	<b>1,693,309</b>
速動比率	2.1x	1.7x
流動比率	2.7x	2.2x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	43	38
存貨周轉天數	123	126

- 預付款項、其他應收款項及其他資產 由上季度末的 4,830 萬美元下降至本季度末的 3,870 萬美元，主要由於收到部分保險賠款。
- 現金及現金等價物 由上季度末的 20.088 億美元上升至本季度末的 22.185 億美元，主要由於前述現金流量分析中闡述的原因。
- 其他應付款項及暫估費用 由上季度末的 5.940 億美元下降至本季度末的 4.418 億美元，主要由於本季度支付資本性開支以及上年度末計提的年終獎金。
- 應付所得稅 由上季度末的 7,620 萬美元上升至本季度末的 9,830 萬美元，主要由於本季度計提所得稅開支所致。
- 淨營運資金 本季度末 20.968 億美元，流動比率 2.7。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 43 天。
- 存貨周轉天數 123 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 [www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)。

華虹半導體有限公司  
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零二三年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二二年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二二年 (未經審核)
銷售收入	630,842	594,648	630,110
銷售成本	(428,645)	(434,625)	(389,403)
<b>毛利</b>	<b>202,197</b>	<b>160,023</b>	<b>240,707</b>
其他收入及收益	32,970	17,721	37,090
投資物業的公平值收益	-	(316)	394
銷售及分銷費用	(2,688)	(4,496)	(2,914)
管理費用	(73,573)	(70,768)	(56,665)
其他費用	(11)	(1,995)	(765)
財務費用	(28,413)	(6,786)	(8,465)
分佔聯營公司溢利	1,520	1,855	7,311
<b>稅前溢利</b>	<b>132,002</b>	<b>95,238</b>	<b>216,693</b>
所得稅抵免/(開支)	8,900	6,865	(30,918)
<b>期內溢利</b>	<b>140,902</b>	<b>102,103</b>	<b>185,775</b>
以下各方應佔利潤			
母公司擁有人	152,234	102,944	159,136
非控股權益	(11,332)	(841)	26,639
持有人應佔每股盈利			
基本	0.116	0.079	0.122
攤薄	0.115	0.078	0.121
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	<b>1,307,286,436</b>	<b>1,301,453,841</b>	<b>1,306,626,546</b>
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	<b>1,318,907,456</b>	<b>1,319,204,155</b>	<b>1,314,496,496</b>

華虹半導體有限公司  
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於三月三十一日 二零二三年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二二年 (已審核)	於三月三十一日 二零二二年 (未經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	3,436,656	3,367,716	3,053,141
投資物業	171,653	169,363	185,369
使用權資產	84,063	78,425	76,681
無形資產	31,217	32,986	33,487
於聯營公司的投資	134,017	130,721	124,420
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	181,597	178,632	236,005
長期預付款項	6,903	7,742	23,710
遞延稅項資產	14,673	14,066	8,715
<b>非流動資產總額</b>	<b>4,060,779</b>	<b>3,979,651</b>	<b>3,741,528</b>
<b>流動資產</b>			
發展中物業	143,960	134,723	125,110
存貨	593,922	578,060	451,671
貿易應收款項及應收票據	306,062	291,856	243,443
預付款項、其他應收款項及其他資產	38,657	48,273	50,060
應收關聯方款項	15,348	13,006	7,074
已凍結存款及定期存款	1,056	1,042	2,258
現金及現金等價物	2,218,547	2,008,765	1,694,934
<b>流動資產總額</b>	<b>3,317,552</b>	<b>3,075,725</b>	<b>2,574,550</b>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	220,243	236,999	243,211
其他應付款項及暫估費用	441,795	593,971	513,204
計息銀行借款	408,669	426,756	194,304
租賃負債	5,582	4,704	2,524
政府補助	38,165	37,714	67,127
應付關聯方款項	7,944	6,096	19,949
應付所得稅	98,314	76,176	67,538
<b>流動負債總額</b>	<b>1,220,712</b>	<b>1,382,416</b>	<b>1,107,857</b>
<b>流動資產淨額</b>	<b>2,096,840</b>	<b>1,693,309</b>	<b>1,466,693</b>
<b>總資產減流動負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
計息銀行借款	1,496,396	1,481,580	1,400,496
租賃負債	19,080	14,644	15,429
遞延稅項負債	11,463	41,268	7,866
<b>非流動負債總額</b>	<b>1,526,939</b>	<b>1,537,492</b>	<b>1,423,791</b>
<b>淨資產</b>	<b>4,630,680</b>	<b>4,135,468</b>	<b>3,784,430</b>
<b>權益和負債權益</b>			
股本	1,996,528	1,994,462	1,987,216
儲備	1,229,318	1,036,008	980,308
本公司擁有人應佔權益	<b>3,225,846</b>	<b>3,030,470</b>	<b>2,967,524</b>
非控股權益	1,404,834	1,104,998	816,906
<b>權益總額</b>	<b>4,630,680</b>	<b>4,135,468</b>	<b>3,784,430</b>

華虹半導體有限公司  
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零二三年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二二年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二二年 (未經審核)
<b>經營活動所得現金流量：</b>			
稅前溢利	132,002	95,238	216,693
折舊及攤銷	120,338	117,227	107,849
應佔聯營公司溢利	(1,520)	(1,855)	(7,311)
營運資金的變動及其它	(118,952)	(15,021)	(132,818)
<b>經營活動所得現金流量淨額</b>	<b>131,868</b>	<b>195,589</b>	<b>184,413</b>
<b>投資活動所用現金流量：</b>			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(216,620)	(124,080)	(331,065)
投資聯營公司	-	-	(4,013)
收到政府對物業、廠房及設備的補助	-	4,356	24,655
其他投資活動所得現金流量	13,339	2,738	7,288
<b>投資活動所用現金流量淨額</b>	<b>(203,281)</b>	<b>(116,986)</b>	<b>(303,135)</b>
<b>融資活動所得現金流量：</b>			
非控股權益資本注資	296,197	-	-
提取銀行貸款	12,972	47,413	181,470
發行股份所得收益	1,442	1,252	1,631
償還銀行貸款	(42,527)	(43,208)	(39,826)
償還租賃負債	(756)	(2,484)	(782)
已付利息	(3,830)	(534)	(31,861)
其他融資活動所(用)/得現金流量	(249)	-	9,509
<b>融資活動所得現金流量淨額</b>	<b>263,249</b>	<b>2,439</b>	<b>120,141</b>
現金及現金等價物增加淨額	191,836	81,042	1,419
外匯匯率變動影響淨額	17,946	3,752	23,118
期初現金及現金等價物	2,008,765	1,610,140	1,984,228
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>2,218,547</b>	<b>1,694,934</b>	<b>2,008,765</b>

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

**非執行董事**

孫國棟

王靖

葉峻

**獨立非執行董事**

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

**承董事會命**

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二三年五月十一日